**发明/实用新型专利申请交底书**

一．**背景技术**

请指出与您的发明创造技术方案最相近的现有技术方案(即，**没有您的发明创造技术方案之前所使用的技术方案**)，且指出所述最相近的现有技术方案中存在的缺陷或不足。（最好指出您的发明技术方案能够解决的问题和缺点）

现有技术： ） 存在的缺点或不足：

**二、发明内容**

请详细描述您的发明创造的技术方案：

1请说明本发明创造包括哪些模块/电路/子电路，并描述各模块/电路/子电路的相互关系(如连接关系或功能关系等), 并描述本发明创造的工作过程或工作原理（如信号的产生、处理、算法等）：

2若本发明创造有方法流程图、测试数据、测试图档、测试结果及相关文件，请以附件的形式上传至自己来平台：

**三、有益效果**

请描述您的发明创造技术方案与上述最相近的现有技术方案相比，您的发明创造技术方案有哪些优点。（您可以从您的发明创造技术方案的结构、功能、制程、成本、效率等方面的提高来解释您的发明创造技术方案的优点）。

**四、替代方案**

对于您在第二部分的发明创造技术方案，您是否还有其他的替代方案同样能实现您的发明创造技术方案（没有不需填写）

**五、其他**

如果发明创造技术方案中的零部件涉及到特殊的形状、尺寸、参数或材料等请您加以说明（没有不需填写）：

**注：\***如果技术方案的工作原理需要对应附图才能说明清楚的专利申请，请您提供图档（模块图、流程图、曲线图等）并上传至赛贝平台